

技術詞彙表

除文義另有所指外，本文件所用與本集團及我們業務有關的若干詞彙的解釋及定義具有下文所載涵義。該等詞彙及其涵義未必與標準行業涵義或用法相符。

「400G」、「800G」、「1.6T」或「3.2T」	指	分別為每秒400吉比特、每秒800吉比特、每秒1.6太比特或每秒3.2太比特，指光學產品實現數據傳輸的速度
「AI」	指	人工智能
「AIDC」	指	人工智能數據中心
「AOC」	指	有源光纜，一種在線纜兩端採用電光轉換技術傳輸數據的線纜技術，保持與標準電氣接口兼容的同時提升線纜的傳輸速度與距離性能
「ASIC」	指	專用集成電路
「AWG」	指	陣列波導光柵，一種光學裝置，通常與光纖耦合，利用由具有精確長度差異的波導陣列所產生的建設性干涉來分離或合併多個波長通道
「BI」	指	商業智能系統
「CAGR」	指	複合年增長率
「CPO」	指	共封裝光學，一種封裝技術，將光引擎直接與ASIC整合在同一封裝內，使其緊密相鄰，從而大幅降低功耗、提高頻寬密度及減少延遲，為傳統可插拔光收發器提供了更優越的替代方案
「數通」	指	數據通信
「EAM」	指	企業資產管理系統
「EHR」	指	電子人力資源管理系統
「ELS」	指	外置光源
「EML」	指	電吸收調制激光器
「ERP」	指	企業資源規劃系統
「FAU」	指	FAU光纖陣列，一種用於對準多根光纖以實現高效光耦合的高精度光學波導元件，廣泛應用於數據中心及電信設備
「GFA」	指	總建築面積
「GPU」	指	圖形處理器，一種專為數字圖像處理及加速電腦圖形設計的專用電子電路，由於其線性代數加速功能，現正越來越多地用於AI處理
「IT」	指	信息技術

技術詞彙表

「LiDAR」	指	激光雷達
「MES」	指	製造執行系統
「NPO」	指	近封裝光學，一種封裝技術，將光引擎置於與ASIC非常接近的同一基板或電路板上
「OA」	指	辦公協作系統
「PLM」	指	產品生命週期管理系統
「ROSA」	指	光接收組件，一種將光信號轉換為電信號的光器件
「研發」	指	研究及開發
「scale-across」	指	數據中心之間的跨域連接
「scale-out」	指	算力集群內及算力集群間的高帶寬連接
「scale-up」	指	單節點內芯片之間的連接
「SiPh」	指	硅光
「電信」	指	電信通信
「TFF」	指	薄膜濾光片，一種光學濾光片，可反射某些波長的光並透射其他波長的光，對所有波長幾乎無吸收；干涉濾光片可為高通、低通、帶通或截止濾光片
「TFLN」	指	薄膜鋰酸鋇
「TOSA」	指	光發射組件，一種將電信號轉換為光信號的光器件
「WDM」	指	波分複用，一種通過使用不同波長的激光，將多個光載波信號複用到單根光纖上的技術，從而實現單根光纖上的雙向通信(亦稱波分雙工)及容量倍增；CWDM指粗波分複用，DWDM指密集波分複用，及LWDM指局域網細波分複用
「WMS」	指	倉儲管理系統
「 μm 」	指	微米，一種公制長度單位，等於百萬分之一米